

## 三次元金属積層造形と創成物内部を透過計測 する産業用 X 線 CT 装置・規格化の最前線

第72回研究会は、切・研削（除去）加工技術と相反する三次元積層造形および創成された立体構造物内部を計測する産業用 X 線 CT 技術・装置及び規格化にスポットをあてます。

前段では、高精度な 3D スキャナーと金属粒子のレーザデポジション方式による次世代積層造形装置の開発経緯・性能の最新情報を提供します。また、後段では、産業用 X 線 CT による創成加工された立体構造物内部の透過計測技術・装置及び規格化への最前線を提供します。

本講演を通じて、次世代の除去加工と積層造形との技術融合などが議論できれば幸いです。

主 催：公益社団法人砥粒加工学会 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会

日 時：2017 年 4 月 28 日(金) 13:00～17:00

会 場：大田区産業プラザ PiO (ピオ) 3F 特別会議室

〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1 丁目 20-20

電話：03-3733-6600 [http:// www.pio-ota.net/](http://www.pio-ota.net/)

交 通： JR 京浜東北線 蒲田駅 徒歩 13 分

京浜急行線 蒲田駅 徒歩 3 分



13:00～13:05	開会挨拶	池野 順一 委員長
13:05～13:55	<講演1> 「3D スキャナーのいままでとこれから」	アメテック (株) クレアフォーム事業部 片桐 友正 氏
13:55～14:45	<講演2> 「レーザデポジション方式による高速金属積層造形装置」	東芝機械 (株) 技術開発部 藤巻 晋平 氏
14:45～15:05	<休 憩>	
15:05～15:55	<講演3> 「産業用マイクロフォーカス X 線 CT 装置の応用例について」	(株) ニコン 産業機器事業部 風間 哲 氏
15:55～16:45	<講演4> 「計測用 X 線 CT の国際標準の開発における現状と展望」	産総研 幾何標準研究グループ 阿部 誠 氏
16:45～16:50	閉会挨拶・事務連絡	池野 順一 委員長
17:10～19:10	技術交流会：PiO (ピオ) 4F レストラン「コルネット」	

参加費(技術交流会含)：次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会会員：無料，非会員：15,000 円 (1 社当り 2 名まで参加)

申込締切日：2017 年 4 月 21 日(金)

(注) 申込頂いた方で当日不参加の場合は参加費を請求させていただきますのでご了承ください

問合せ/申込先：当専門委員会事務局 田附宙美 宛

FAX：FAX:048-829-7046, E-mail：[sf-office@mech.saitama-u.ac.jp](mailto:sf-office@mech.saitama-u.ac.jp)

※申し込み用紙はこちら→<http://spe.mech.saitama-u.ac.jp/mysite5/application2017ver2.pdf>